U.D.C. 621.315.592:546.28 621.382:621.314.63

2,500V-400A CH03 形サイリスタの電流容量についての考察

Current Capability of Type CH 03 (2,500 V-400 A) Unit Cell Thyristor



要 旨

大容量圧延機用直流電動機にサイリスタ変換器も大容量化してきた。これに伴いサイリスタ素子もユニット セル形構造が採用され、大容量化が進んでいる。日立製作所のユニットセル形構造素子はダイオードではF01, C01 形整流素子が、またサイリスタでは2,500V-400A CH03 形サイリスタが完成し、電力用半導体装置の主 整流素子として採用されている。ユニットセル形構造は、その特長である低熱抵抗が大容量素子の必要条件を 満たすもので、今後さらに多く出現することが推測される。

従来多く採用されているスタッド構造素子では、実効電流一定で制約されていたのに対し、その構造上の特 長により接合最高温度と負荷電流によるくり返し温度差のみで制約されるという違いが出てきた。本稿では CH03 形サイリスタにつきユニットセル形構造素子の瞬時過電流耐量 (Surge) およびターンオン過渡時の現象 に関連しない定常負荷について考察する。

1. 緒 言

分塊,厚板,ホットストリップ,コールドストリップなどの大容 量圧延機にサイリスタ変換器が全面的に採用されるようになり,サ イリスタ素子の大容量化が要求されるようになってきた。通例サイ リスタ接合にとって,高耐圧化と大電流化とでは設計,製作上の処 方が対立しており,高耐圧接合は順損失増大をまねき,それだけ順 電流容量が低下することを避けがたいものとする。ここに高損失を 処理できる低熱抵抗構造が高耐圧大電流素子の製作を可能にする一 つの方法として必要となる。



図1はスタッド形構造の一例で,発生損失熱が一方向に放散する 単方向熱放散であるのに対し,ユニットセル形構造では図2に示し たように両方向二重熱放散方式をとっているので,実効的に熱抵抗 は著しく低減される。

負荷電流は素子が想定寿命内で信頼度を確保し長期運転に耐え, また規定された定格条項が保証された値を保つように,その許容量 が設定される。この意味で負荷電流はおもに

(a) 最高接合温度

(b) 接合温度差 (Soldering Type の場合ベース温度差も含む)

(c) 構成材料の電流容量

で規定される。これらは絶対最大定格を規定する要素として考える 場合,律則過程をとる事項により制限をうけることになる。ユニッ トセル形構造ではリード線などの構成がないので,素子自体の立場 からみると(a)と(b)項で決まることが多いのである。このことは スタッド構造と異なり,冷却条件により許容電流は変わり,使用条 件を考慮して負荷電流の設定が自由であることを意味すると同時 に,使用するにあたり最高接合温度および接合温度差が素子の信頼 度,特性にどのように影響するかを認識せねばならない。これらの 要素は,それぞれ異なったモードで素子の信頼性,特性に影響する ものである。半導体装置の信頼性,経済性は設計の重要な指針であ ると考える。本稿ではCH03形ユニットセル形構造サイリスタを例 として,これらより決まる電流容量の設定法を検討する。なお前述 のように瞬時非くり返し過電流およびスイッチング損失に関連する

領域については別途報告する商用周波数近傍の定常電流について論 ずることにする。

CH03 形サイリスタの一般的定格,特性については表1にかかげた。これらはCH03 形サイリスタの標準仕様である。図3はその外形寸法である。

* 日立製作所日立工場

2,500 V-400 A CH 03 形サイリスタの電流容量についての考察

表1 CH 0.5	3 正恰およ	の特性			
形式	CH 03 R	CH03CA	CH03CD	CH03CF	
定格条項 CES形名	1				
定格せん頭逆耐電圧(V) peak	1,800	2,000	2,300	2, 500	
定格せん頭過渡逆耐電圧(V) peak	1,950	2,200	2, 550	2,750	
定格せん頭順阻止電圧(V) peak	1,800	2,000	2, 300	2,500	
定格平均順電流(A) ave	400 (400 (単相半波 180° 通流 TB: -40~+75℃, 抵抗負荷)			
定格瞬時過電流(A) peak	x 7,000 (1	7,000 (10 ms 通流,正弦半波1サイクル)			
最大順電 E 降 下 (V) peak	x 2.3 (2.3 (単相半波せん頭値 1,000A,) 通流角 180°			
定格せん頭ゲート入力 (W) peak	c	20			
定格平均ゲート入力(W) ave		4			
定格せん頭ゲート電圧 (V) peak	c J	順方向: 20, 逆方向: 5			
定格せん頭ゲート電流 (A) peal	ς	4			
最小ゲートトリガ電圧 (V) DC	4 (T_j	4 (T _j :25℃, AK間順電圧6V DC)			
最大ゲート非トリガ電圧 (V) DC	0.1 $\begin{pmatrix} T \\ A \end{pmatrix}$	$0.1 \begin{pmatrix} T_j : -40 \sim +125 \circ C, \\ AK間順電圧 6 V DC \end{pmatrix}$			
最小ゲートトリガ電流 (mA)DC	C 300 (T	300 (T _j : 25℃, AK間順電圧6VDC)			
最大ゲート非トリガ電流 (mA)D($C = 1.5 \begin{pmatrix} T \\ A \end{pmatrix}$	1.5 $\begin{pmatrix} T_j : -40 \sim +125 \degree C, \\ AK間順電圧 6 V DC \end{pmatrix}$			
動 作 接 合 温 度 (℃)		$-40 \sim +125$			
保 管 温 度(℃)		$-40 \sim +125$			
接合冷却体間熱抵抗(℃/W)		0.05			
最大加 圧 荷 重 (kg)		1,000			
重 量 (g)		230			
2. 記 A, K ₁ , K ₂ : 接合の a, b: 計算の) 常数) 常数	号			
FVD, FVD(i): 順電日	二降 卜				
P, P_{AVE}, P_w : 損	失				
$i, i_p i_d$: $factors$	流				
$\theta, \alpha, \Delta \theta$: \mathbb{E}	i 角	lor 1.1.			
θ ∞: 飽和した	こ按合の熱	、抵抗			
0 . 炭t t	to the				

CIIのつは扱みとアド性M







3. 接 合 温 度

負荷電流を規制するのはいずれのパターンであっても接合温度で 決まる。特に負荷電流についてはまず接合温度上昇を考えるのが出 発点である。接合温度上昇は発生損失と熱抵抗の要素で決まる。こ れらの要素はともに時間の関数であるので, 接合温度上昇もまた時 間を変数とする関数となる。定常負荷電流であっても時間を考慮の うちに入れて検討しなければならない。

順電圧降下と損失 3.1

順電流 i による順電圧降下は次のように与えられる。

 $FVD(i) = A + \frac{1}{kT} \ln i + K_1 \sqrt{i} + K_2 i$ (1)

正弦波波形 図 5



図6 方形波波形



図7 正弦波損失特性 ここで、 A, K_1, K_2 は素子の決定する常数であり、kは物理常数、Tは温度である。(1)式で与えられた式の実験値を図4で示した。こ れはCH03の FVD-i 特性の実測値である。(1)式はまた,図4よ 求めると, $i=i_p\sin\theta$ (3) り実験式で この値を導入して(2)式で損失を求めると FVD(i) = a + bi(2) $p = i \cdot FVD(i) = i_p \sin \theta \cdot (a + b i_p \sin \theta) \dots (4)$ と近似的に変えても計算する電流領域では誤差は小さい。 となる。通流期間の平均損失 Pw は 順電流を図5のようにipをせん頭値とした正弦波として損失を ---- 67 -----



である。(1)式についての損失は付録 I. に記載したとおりである。 なお全域平均損失は

である。方形波の損失は図6として考えると

 $P_w = i_p \cdot FVD(i_p) = ai_p + bi_p^2$ (7) である。図7,8は順電流平均値と全域平均損失の関係を示したもの

である。なお,順電流平均値 ia は

正弦波
$$i_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} i_p \sin \theta \, d\theta = \frac{1 + \cos \alpha}{2\pi} i_p$$

方形波 $i_d = \gamma \cdot i_p$ (8)

により算出された。

3.2 熱 抵 抗

接合を損失発生源とし熱抵抗を求めるとCH03形サイリスタの場合図9のようになる。熱抵抗は構成材料の物理常数と寸法により決まるもので、おのおのの構成材料の熱時定数と時間関数の重合した形で示され、これらのパラメータで決まる飽和点以上で一定となる。 ニニットセル構造の熱抵抗の論述はここでは行なわない。図8は実験と理論計算の修正で得られたものである。

3.3 接合温度上昇の計算

接合温度上昇の計算方法は各種提案されているが, 直観的に考察 しやすい重合法で考えることにした。

順電流に対応する温度上昇は

$$\Delta T_{j(t=t_f)} = P_{\text{AVE}} \{ \boldsymbol{\theta}_{\infty} - \boldsymbol{\theta}(t_f) \} + P_{w} \cdot \boldsymbol{\theta}(t_f)$$

$$= P_{\text{AVE}} \cdot \left\{ \boldsymbol{\theta}_{\infty} + \left(\frac{1}{\gamma} - 1\right) \boldsymbol{\theta}(t_f) \right\} \dots \dots \dots \dots \dots (9)$$

順電流休止期間の最終点 $t=t_{s'}$ の温度上昇は $\int T_{j(t=t_{s'})} = P_{AVE} \{ \theta_{\infty} - \theta(t_{s'}) \} + P_{w} \theta(t_{s'}) \} - P_{w} \theta(t_{s'}-t_{f})$

......(11)

で与えられる。ある周波数の1 サイクルの接合温度差は $\Delta T_{jEXC} = \Delta T_{jmax} - \Delta T_{j(t=t_s')}$ (12)で求められる。

3.4 接 合 温 度

接合温度 T_i は周囲温度 T_{AMB} とフィン温度上昇 ΔT_{FIN} および接合温度上昇で求められる。

 $\Delta T_{\text{FIN}} = P_{\text{AVE}} \cdot \theta_{\text{F-A}}$ (14) で表わされ θ_{FA} はフィンと冷却媒体間の熱抵抗である。なお、 ΔT_j の中にユニットセルのポストとフィンの接触熱抵抗を含ませておいた。接合温度 T_j は前述のように素子の信頼度、保証定格および特性より決定されるので、その素子自体で決まる値である。CH03 の場合は 125°C である。

接合温度に着目すると(9),(13),(14)式より

で最大許容損失が T_{AMB}, θ_{F-A} を決めることで求まる(付録 Ⅲ.)。 (5),(6),(7)式から許容せん頭電流,また(8)式より平均順電流 が求められる。

4. 短時間過負荷耐量

最高接合温度および接合温度差を規定内に押えているかぎり,熱

で求まる。しかし正弦波電流のように時間変位のある負荷では $t=t_f$ で最高温度になるとはかぎらない。正弦波電流の場合(付録II.)は次の式で求められる。

$$\Delta T_{j\max} = P_{AV} \{ \boldsymbol{\theta}_{\infty} - \boldsymbol{\theta} (n \cdot \Delta t) \} + \frac{1}{\Delta \theta} \Big\{ \boldsymbol{\theta} (t_{f}) \cdot \int_{\theta_{0}}^{\theta_{1}} FVD(i) \, i \, d\theta \\ + \sum_{n=1}^{r} \boldsymbol{\theta} \{ t_{f} - (n-1) \, \Delta t \} \cdot \int_{\theta_{n-2}}^{\theta_{n}} FVD(i) \, i \, d\theta$$

抵抗の過渡特性を利用し,短時間くり返し過電流を通流することが できる。図10の間欠負荷電流に対して接合温度を算出すると(16), (17),(18)式となる。

$$\Delta T_{jt=t_{\rm ON}} = \left(\frac{t_{\rm ON}}{2t_{\rm CY}} \{\boldsymbol{\theta}_{\infty} + \boldsymbol{\theta}_{\rm F-A} - \boldsymbol{\theta}(t_{\rm ON})\}\right)$$

---- 68 -----

$$+\frac{1}{2}\left\{\boldsymbol{\theta}(t_{\rm ON})-\boldsymbol{\theta}(t_0+t_s')\right\}+\boldsymbol{\theta}(t_0)-\boldsymbol{\theta}(t_s')\right\}\cdot P_{w} \quad \dots \dots \dots (16)$$

2,500 V-400 A CH03 形サイリスタの電流容量についての考察



749

この場合

 $T_{j} = \varDelta T_{jt} = t_{\rm ON} + T_{\rm AMB} \qquad (19)$ の接合温度を保つことが必要条件であると同時に AT jexc について も考慮する必要がある。 AT jExc については、これが機械的エネルギ ーに変換され交播ひずみとして接合に影響するから、 *dT*_{iExc}の耐量 も信頼度設計上重要な要素となる。 CH03 形 サイリスタの ΔT_{jEXC} とくり返し耐量を示したのが図11である。この特性を考慮し、適 用する装置の耐久期間と信頼性を設定して負荷条件を選定すること が装置の経済設計上必要となろう。この場合(12)式で与えられた1 サイリクル内の ΔT_{jEXC} の値も一応は検討しておき (18) 式の T_{jEXC} とどちらで決定されるかも比較しておく。(16), (17), (18), (19)式 を用いて決まった *dT*_{JEXC} より負荷電流の許容値を逆算することが できる。

5. CH 03 形サイリスタの電流容量

電流容量を決定する条件について述べてきた。また電流容量とし

図14 CH03 時間負荷電流特性の一例

できる程度で、稼働サイクルによる温度差も影響しない程度の状態 として考え温度差は(12)式の使用周波数の1サイクル温度差のみを 考える。このような条件ではTiは定格内に、またフィンの熱抵抗, 周囲温度によってきまる(13)式から求められる(図12,13)。 CH03 形サイリスタの定格 400A とあるのは上記した温度差を考慮に入れ 接合温度上昇50℃と設定したものである。フィンの熱抵抗周囲温 度,信頼性を考慮し(15)式より負荷電流を設定していくのが装置の 経済性設計となる。

5.2 短時間(間欠)過負荷特性

---- 69 -----

半導体装置の使用において、ある程度のひん度で短時間過負荷電 流が流れることが予測されるケースが多い。この場合信頼度を保つ ため,短時間過負荷電流を素子の定常電流に合わせて設計すること は,装置の経済性上不利となる場合がある。また溶接機などの短時 間大電流の負荷を想定する場合など短時間過負荷特性がわかれば有 効な利用ができる。冷却条件など多くの要因がはいってくるので, 個々には3.の計算式により求めるしかないが、一例として CH03 形サイリスタの計算結果を図14にかかげた。装置の設計にあたっ ては、図10,11を検討し装置の耐久性および使用条件を考慮して負 荷電流を設定すればよい。負荷電流は冷却条件などで考慮しなけれ

て連続通電の容量と短時間間欠過負荷容量の設定法についても検討	
した。ここではCH03形サイリスタにつき具体的な計算を行ない検	
討してみる。	

5.1 連続電流(定常時)容量

連続定常負荷電流でも装置の運転稼働と休止では(9),(10)式の △T_iがそのまま接合温度差となるので,稼働サイクルの多い使用条 件では間欠負荷使用の状態にはいる。ここでは稼働サイクルが無視

ばならないことはもちろん素子および装置の耐久性, 信頼性を検討 して決められる。 以上電流容量につき述べたが, ユニットセル形構造の電流容量は スタッド形に実効規制があるのに対して素子の信頼性を設定して, それより負荷電流を規制する形で求められる。ここに装置の信頼 性,経済性より規制される電流容量となり,素子からの規制は接合 温度と図10の信頼度パターンがあるだけとなる。



図15 サブサイクルの温度上昇

6. 結 言

ニニットセル形構造の素子は低熱抵抗であるので,定常時の電流 容量が大きくとれることになる。またスタッド形構造に比べ外条件 に順応性がよくなっている。それだけに素子の性格をよく検討し電 流容量を決める必要がある。

ニニットセル形構造は、上記のように定常時の電流を増大するこ とは容易であり、さらに大容量化が進むと考えられるが一方、本報 告では触れなかったが瞬時過電流耐量は必ずしも定常電流容量に比 例して増加しないので、装置の保護上に問題がある。定常電流値よ りもこのサージ電流耐量による制限がこのユニットセル形構造素子 の限界を規制する可能性がある。このことは将来サイリスタ素子の 大容量化に大きな問題をなげかけると考えられるが、これについて は別途報告する予定である。 付録 II. サブサイクル内の温度上昇

図15 で示したように負荷電流のサブサイクルの時間をm分割して近似的に求める。



本稿を終わるにあたり,本素子開発について終始ご指導賜わった 日立製作所日立工場整流器部浅野部長,守田主任技師,曽根田課長 はじめ関係各位にお礼申し上げる。

参考文献

(1) 浅野: オーム 昭和41年10月号 p.18~25
(2) 佐々木,和島: 日立評論 49,1096(昭42-11)
(3) 和島,天野: 日立評論 49,332(昭42-3)
(4) G.E.: SCR Manual 3rd. 1964年版, p.21~30

付録 I. 低電流域を含めた損失

(1) 正弦波電流

$$i=i_p\sin\theta$$
(I-1)

$$P(i) = i \cdot FVD(i) = i_p \sin \theta \left\{ A + \frac{1}{kT} \ln i_p \sin \theta + K_1 \sqrt{i_p \sin \theta} + K_2 i_p \sin \theta \right\} \dots \dots \dots \dots (I-3)$$

通流期間の平均損失

$$P_{w} = \frac{1}{\pi - \alpha} \int_{\alpha}^{\pi} i_{p} \sin \theta \left\{ A + \frac{1}{kT} \ln i_{p} \sin \theta + K_{2} \sqrt{i_{p} \sin \theta} + K_{2} i_{p} \sin \theta \right\} d\theta \dots (1 - 4)$$

$$= \frac{i_{p}}{\pi - \alpha} \left\{ (A + \frac{1}{kT} \ln i_{p}) (1 + \cos \alpha) + \left(\cos \alpha (\ln \sin \alpha - 1) - 0.3 - \ln \left| \tan \frac{\alpha}{2} \right| \right) \cdot \frac{1}{kT} \right\}$$

がサブサイクルの温度上昇である。このサブサイクル負荷以前に十分な時間負荷があったとしたら T_{jmax} は

となる。

— 70 —

付録 III. 損失より電流を求める

許容損失 P は

で与えられる場合(本文(15)式)は順電流は損失特性より図解できる。ここでFVDを次の式で表わすと計算により求まる。

$$FVD(i) = a + bi$$
(Ⅲ-2)
とすれば損失 P_w は

$$P_w(i) = a'i_p + b'i_p^2$$
(III-3)
で求まる。ここで a', b' は正弦波の場合

$$a' = \frac{1 + \cos \alpha}{\pi - \alpha} a, \quad b' = \frac{b}{2} + \frac{\sin 2\alpha}{2(\pi - \alpha)} \quad \dots \dots \dots (\text{III}-4)$$

であり方形波では a'=a, b'=b(III-5) である。(III-1),(III-3)式より $P \equiv P_w(i)$ とすれば $P=a'i_p+bi_{p}^2$ (III-6) を解けばよい。根を求めて負根を除くと



